

## 関西支部 2021 年度第 2 回講演会のご案内

(社) 低温工学・超電導学会関西支部 支部長 武田 実

2021 年 9 月 13 日

近年、ポスト情報化社会への変遷が加速する中で研究開発への要請も変わりつつあります。特に企業においては従来のように先端技術により製品の高性能化、高品質化を図ることだけではなく、製品価値を高めて市場にアピールする魅力的なアプリケーションを生み出すことが求められるようになってきております。また、そうした中で、なにもかもを自社で行うことは不可能になり、外部リソース活用の観点から技術調達のネットワークの重要性が高まっております。

今回の講演会では、始めに技術者として調達を行っておられる立場から、これらからのこれからの研究者、技術者が持つべき視点についてのお話をいただきます。また続いて、技術開発の効率化を図る観点からは、得意分野以外はアウトソーシングするような社会構造になりつつあるなかで、そうした観点から半導体開発における成膜材料や成膜プロセスの開発についてのお話を伺います。

今回の講演会は、これまでに当支部で開催しておりました分野とは少し異なるテーマとなっております。この機会に視野を拡げていただき、皆様の低温・超電導分野での研究開発のヒントにさせていただきたく、多くの方々のご参加をお待ちしております。

テーマ：企業から見える先端技術開発の現況

日時：2021 年 11 月 2 日（金）14：00～16：00

場所：Web 方式による開催（URL は参加者に別途連絡いたします。）

参加費（税込・資料代として）：1,000 円（学生）、2,000 円（支部会員、学会員、事業会員、賛助会員）、3,000 円（その他）

お支払いには Paypal を使用し、メールにて請求をさせていただきます。

### プログラム

14：00～14：05 「開会挨拶」 関西支部支部長

- 14 : 05~14 : 55 「技術者が越えるべき壁～技術調達の視点から」  
柴田 聡 氏（株式会社パナソニック）
- 14 : 55~15 : 00 休憩
- 15 : 00~15 : 50 「（仮）成膜材料と成膜プロセスについて」  
安原 重雄 氏（株式会社ジャパン・アドバンスド・ケ  
ミカルズ）
- 15 : 50~16 : 00 「閉会挨拶」 関西支部副支部長

**申込方法：** (1)氏名、(2)所属、(3)連絡先（TEL、E-mail）、(4)会員・その他の区別 について、「11月2日 第2回関西支部講演会申込」として、10月22日（金）までに電子メールにて下記担当幹事までお申し込み下さい。

**担当幹事：** ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社 斉藤一功  
TEL:078-992-5720 Email : saito.kazuyoshi（アットマーク⇒記号に変換くだ  
さい） kobelco.com

大阪大学レーザー科学研究所 村上博成  
TEL: 06-6879-7982 Email : hiro（アットマーク⇒記号に変換ください）  
ile.osaka-u.ac.jp

以上